電子部品製造スキームについて

２０２５年４月

インド政府が 3 月 28 日に電気・電子分野で合計 2,291 億 9,000 万ルピー（約 3,896 億 2,300 万円、1 ルピー＝約 1.7 円）の補助金制度を承認したことを受け、インド電子・情報技術省は 4 月 8 日、電子部品製造優遇スキームの詳細を発表いたしました。5 月 13 日にインベストインディア主催でオンラインウェビナーも実施いたしますのでお知らせいたします。

■参考：

・インド政府 HP（スキーム官報（通知）掲載）
https://www.meity.gov.in/offerings/schemes-and-services/details/electronics-component-manufacturing-scheme
・インド政府プレスリリース（2025 年 3 月 28 日）
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2116174
・インド政府プレスリリース（2025 年 4 月 8 日）
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2120240

■対象分野：

・サブアッセンブリ
・ベアコンポーネント
・特定ベアコンポーネント
・サプライチェーンエコシステムおよび資本的設備
※分野に応じて補助金の性質が異なる（詳細は下記資料参照）。
https://www.jetro.go.jp/view_interface.php?blockId=39556183

■補助金の性質：

・サブアッセンブリ、ベアコンポーネント
基準年比に対する純売上高増分に応じて 6 年間支給される売上高連動型補助金となっており、売上高増加、累積投資額の閾値（いきち）を毎年満たす必要がある。雇用についても累積増加数の閾値があり、閾値を満たせなかった場合には補助額が減額される。

・サプライチェーンエコシステムおよび資本的設備
設備投資補助金が支給される。投資額の閾値を毎年満たす必要があるのに加えて、商業生産の開始が条件となっている。売上高連動型補助金と同様に、雇用についても累積増加数の閾値があり、閾値を満たせなかった場合は補助額が減額される。

・特定ベアコンポーネント
売上高連動型補助金と設備投資補助金のハイブリット型となっている。

■申請期間：

・サブアッセンブリ、ベアコンポーネント、特定ベアコンポーネント
2025 年 5 月 1 日から 3 カ月間（延長や再募集の可能性あり）

・サプライチェーンエコシステムおよび資本的設備
2025 年 5 月 1 日から 2 年間

※インド電子・情報技術省はガイドラインの発出を近日中に予定しており、申請方法なども含めた詳細が定められる見込み。

■インベストインディア主催説明会：

電子部品製造スキームに関する説明会を 5 月 13 日にインベストインディアが実施予定です。本スキームにつき、ご関心ございましたら登録フォームよりお申込みの上、是非ご参加いただければと思います。

趣旨：Invest India, in collaboration with EY as Knowledge Advisor, is pleased to invite you to an exclusive webinar on "India's Electronics Component Manufacturing Opportunity & Incentive Scheme (ECMS)". This webinar will highlight the emerging opportunities in India's electronics component ecosystem and provide insights into how the new incentive structure can support industry players and investors.
日時：2025 年 5 月 13 日（火）インド時間 10:30～11:30（日本時間 14:00～15:00）
会議形式：オンライン(Cisco Webex)
言語：英語
登録フォーム（ウェビナー直前まで登録可能）：
https://investindiavc.webex.com/weblink/register/r434e1e348de0388cc8ae91201d615f8f
※詳細なアジェンダは登録者に後日送付予定

ご関心・ご質問等がございましたら、以下のお問合せ先までご連絡ください。

【お問合せ】
インベストインディア・ジャパンプラス 花村
（E-mail: Daiki_Hanamura@jetro.go.jp）